

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

Process for making a circuit board.

Patent Number: EP0062300
Publication date: 1982-10-13
Inventor(s): BAUMANN KLAUS
Applicant(s): WITTIG FRITZ SCHALTUNGEN
Requested Patent: EP0062300
Application EP19820102745 19820331
Priority Number(s): DE19813113855 19810406
IPC Classification: H05K3/02; H05K3/24; H05K3/42
EC Classification: C23F1/02, H05K3/02M, H05K3/06B2
Equivalents: DE3113855

Abstract

A process for making a circuit board is described in which an etching resist layer 8 is applied instead of the normal photographic treatment or screen printing for forming the conductor path pattern on the penetrating copper layer 6 of the blank. The etching resist layer 8 is vaporised by means of a laser beam, in accordance with the desired conductor path pattern, and the remaining copper layer on the points removed by the laser treatment is etched away down to the surface of the plastic board 1. 

Data supplied from the esp@cenet database - I2



⑫

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

⑯ Anmeldenummer: 82102745.5

⑮ Int. Cl.³: H 05 K 3/02, H 05 K 3/24,
H 05 K 3/42

⑰ Anmeldetag: 31.03.82

⑲ Priorität: 06.04.81 DE 3113855

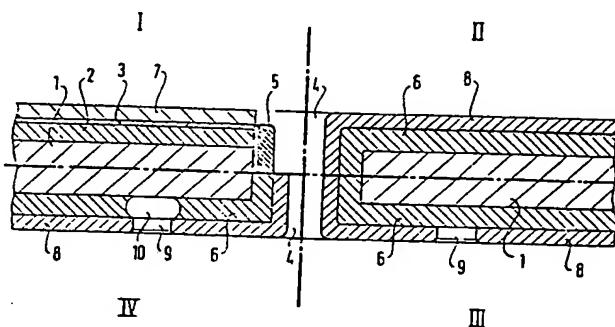
⑳ Anmelder: FRITZ WITTIG Herstellung gedruckter
Schaltungen, Konrad-Celtis-Strasse 81,
D-8000 München 70 (DE)㉑ Veröffentlichungstag der Anmeldung: 13.10.82
Patentblatt 82/41㉒ Erfinder: Baumann, Klaus, Flöderweg 1,
D-8000 München 90 (DE)

㉓ Benannte Vertragsstaaten: DE FR GB IT

㉔ Vertreter: Ebbinghaus, Dieter et al, K.L. Schiff Dr. A. von
Funer Dipl.-Ing. P. Strehl Dr. U. Schübel-Hopf Dipl.-Ing.
D. Ebbinghaus Dr. Ing. D. Finck Patentanwälte
Marienhilfplatz 2 & 3, D-8000 München 90 (DE)

㉕ Verfahren und Herstellung von Leiterplatten.

㉖ Es ist ein Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten beschrieben, bei dem statt der üblichen Fotobehandlung oder Siebdruck zur Bildung des Leiterbahnenmusters auf die durchgehende Kupferschicht 6 des Rohlings eine Ätzresistschicht 8 aufgebracht wird. Die Ätzresistschicht 8 wird entsprechend dem gewünschten Leiterbahnenmuster mittels eines Laserstrahls verdampft und die verbleibende Kupferschicht an den durch die Laserbehandlung entfernten Stellen bis zur Oberfläche der Kunststoffplatte 1 weggeätzt.



VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON LEITERPLATTEN

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten, bei dem auf eine Kunststoffplatte oder -folie zumindest einseitig eine Kupferschicht aufgebracht und danach das Leiterbahnenmuster in der Kupferschicht gebildet wird.

- Herkömmlicherweise werden bei der Herstellung von Leiterplatten die beidseitig mit einer Kupferkaschierung angelieferten Kunststoffplatten nach dem Bohren der Durchgangsbohrungen mit einer schwachen Kupferschicht überzogen, die die Kupferkaschierung und die Oberfläche der Durchgangsbohrungen bedeckt. Auf die so gebildete Kupferschicht wird eine Fotoresistschicht aufgewalzt. Hierauf wird auf die Fotoresistschicht die Strichmaske aufgelegt, belichtet und nach dem Entfernen der Maske die Fotoresistschicht entwickelt, wobei die für eine weitere Kupferbeschichtung freibleibenden Oberflächenbereiche der Kunststoffplatte von der Fotoresistschicht befreit werden. Es verbleiben die gewünschten Leiterbahnen und Bohrungen der Leiterplatte. Die Leiterbahnen werden anschließend galvanisch verstärkt und z.B. in einem Zinnbad mit Zinn galvanisiert.
-
- Die bekannte Art der Herstellung von Leiterplatten ist verhältnismäßig arbeitsaufwendig. Insbesondere aber ist die Leiterbahnendichte, da das Eindringen von Staubteilchen in der Fertigung praktisch unvermeidbar ist, verhältnismäßig gering. Treibt man nach dem bekannten Herstellungsverfahren die Leiterbahnendichte über ein bestimmtes Höchstmaß hinaus, so kommt es wegen der unvermeidlichen Staubteilchen zu Kurzschlüssen zwischen einzelnen Leiterbahnen, Einschnürungen oder Unterbrechungen und damit zu einem wirtschaftlich nicht mehr zu vertretenden Ausschußanteil.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten anzugeben, das eine weitere Erhöhung der zulässigen Leiterdichte ermöglicht.

5

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß zur Ausbildung des Leiterbahnenmusters eine Ätzresistschicht auf die Kupferschicht aufgebracht wird, die Ätzresistschicht entsprechend dem gewünschten Leiterbahnenmuster mittels 10 eines Laserstrahls selektiv verdampft und die verbleibende Kupferschicht an den durch die Laserbehandlung entfernten Stellen bis zur Oberfläche der Kunststoffplatte weggeätzt wird.

15 Da bei dem erfindungsgemäßen Vorgehen der als Schneidwerkzeug dienende Laserstrahl sehr scharf gebündelt werden kann, kann der Abstand zwischen den einzelnen Leiterbahnen sehr gering gehalten werden. Auf der durch den Laserstrahl aufzuschneidenden Ätzresistschicht liegende Staubpartikel werden 20 durch den Laserstrahl weggebrannt. Die Leiterbahndichte läßt sich daher beträchtlich erhöhen. Während bisher bei einem Raster von 2,54 mm und einer Augengröße von ca. 1,5 mm zwischen zwei Bauteilanschlüssen zwei bis drei Leiterbahnen hindurchgeführt werden konnten, lassen sich bei 25 Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens zwischen zwei Bauteilanschlüssen entsprechend bis zu acht Leiterbahnen hindurchführen. Dabei entsteht weniger Ausschuß als bisher, da sich das Leiterbild bei Steuerung mittels eines Rechners vollautomatisch erstellen läßt. Hinzu kommt, daß der gesamte 30 Fotoprozeß entfällt, der einen Hauptkostenfaktor an Personal und Material des bekannten Verfahrens darstellt. Bei Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens läßt sich dagegen bei entsprechender Software das Leiterbild direkt aus dem CAD (computer aided design)-Speicher auf die Platte übertragen. Zwischenträger und Werkzeuge wie Druckvorlagen und 35 Filme sind nicht mehr notwendig. Wegen der größeren Packungsdichte läßt sich auch ein beträchtlicher Rückgang des

Multilayeranteils bzw. der Lagenzahl verwirklichen, wo-
durch sich weitere Kosteneinsparungen ergeben. Schließlich
läßt sich bei Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens
der Kupferverbrauch beträchtlich verringern, da die einzel-
5nen Kupferschichten wesentlich dünner ausgeführt werden
können, und nicht mehr soviel Fläche abgeätzt wird.

Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren lassen sich bei der
Herstellung von Multilayer-Platten die Innenlagen her-
10stellen.

Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung des erfindungsgemäßen
Verfahrens wird bei - an sich üblicher - beidseitiger
Kupferbeschichtung der Kunststoffplatte nach dem Bohren der
15 Durchgangslöcher und dem Vorverkupfern der Oberfläche der
Durchgangslöcher auf die verstärkte Kaschierung eine Lack-
schicht aufgetragen, worauf die Kupferschicht in den Durch-
gangslöchern verstärkt wird. Bei Multilayer-Platten wird
erst nach der Zusammenstellung sämtlicher Platten gebohrt.
20

Die Erfindung wird im folgenden durch ein Ausführungsbeispiel
anhand der Zeichnung näher erläutert. Die Zeichnung
zeigt den schematischen Querschnitt einer Leiterplatte wäh-
rend verschiedener Phasen der Herstellung.
25

Die Leiterplatte 1 wird mit einer etwa 5 bis 12 µm starken
Kupferkaschierung 2 angeliefert (Quadrant I). Nach dem
Bohren der Durchgangslöcher 4 wird, wie ebenfalls im Qua-
drant I gezeigt, auf die Kupferkaschierung 2 in einem
30 chemischen und anschließenden galvanischen Arbeitsgang eine
5 bis 7 µm dicke Verkupferungsschicht 3 aufgetragen. Die
Verkupferungsschicht 3 wird darauf mittels einer Lackschicht
7 abgedeckt und die Oberfläche in der Durchgangsbohrung 4
galvanisch mit einer Verstärkungsschicht 5 von 25 bis 30 µm
35 Dicke versehen. Die Lackschicht 7 wird anschließend wieder
entfernt. Das Ergebnis ist eine Kunststoffplatte 1 mit einer
durchgehenden Kupferschicht 6 (Quadranten II, III und IV).

Auf die Kupferschicht 6 wird nun eine beispielsweise aus Pb-Sn bestehende Ätzresistschicht 8 aufgetragen (Quadrant II) und dann umgeschmolzen. Die Schmelztemperatur der Ätzresistschicht 8 darf die üblicherweise angewandte Löttemperatur nicht überschreiten. Anschließend wird die Ätzresistschicht längs vorgegebener Bahnen mittels eines Laserstrahls verdampft. Hierzu wird der Laserkopf oder der Werkstücktisch der Bearbeitungsvorrichtung, gesteuert von einem Rechner, entsprechend den gewünschten Bahnen geführt. Als Programmspeicher kann hierbei der Speicher des Rechners selbst oder ein Band- oder Plattspeicher dienen.

Eine trägheitsfreie und damit noch schnellere Bearbeitung ist möglich, wenn statt des Laserkopfes oder des Werkstücktisches mittels Ablenksystemen der Laserstrahl selbst längs den gewünschten Bahnen gelenkt wird.

Nach dem partiellen Verdampfen der Ätzresistschicht 8, wo bei der in den Quadranten III und IV gezeigte Kanal 9 entsteht, wird die Leiterplatte schließlich bis hinab zur Oberfläche der Kunststoffplatte 1 geätzt, wobei, getrennt durch die Ätzung 10, die einzelnen Leiterbahnen der Leiterplatte entstehen. Anschließend wird der Ätzresist durch Strippen vollständig (Oberfläche und Bohrungen) entfernt, und ein Lötschicht-Resist in Siebdruck- oder Fototechnik aufgebracht. Anschließend werden die Augen und Durchgangslöcher mittels des Heißluft-Verzinnungsverfahrens (Hot Air Levelling) verzinnt. Die Leiterplatte ist damit, bis auf die übliche Endbehandlung, fertig.

5 P a t e n t a n s p r ü c h e

1. Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten, bei dem auf
einen Kunststoffträger (1) zumindest einseitig eine
Kupferschicht (6) aufgebracht und danach das Leiter-
bahnenmuster in der Kupferschicht (6) gebildet wird, da-
durch g e k e n n z e i c h n e t , daß zur Ausbildung
des Leiterbahnenmusters eine metallische Ätzresistschicht
(8) auf die Kupferschicht (6) aufgebracht wird, die Ätz-
resistschicht (8) entsprechend dem gewünschten Leiter-
bahnenmuster mittels eines Laserstrahls selektiv ver-
dampft und die verbleibende Kupferschicht (6) an den
durch die Laserbehandlung entfernten Stellen (Kanal 9)
bis zur Oberfläche der Kunststoffplatte (1) weggeätzt
wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n -
z e i c h n e t , daß bei beidseitiger Kupferbeschichtung
des Kunststoffträgers (1) nach dem Bohren der Durch-
gangslöcher (4) und dem Vorverkupfern der Oberfläche der
Durchgangslöcher auf die Kupferschicht (6) eine Lack-
schicht (7) aufgetragen wird, worauf die Kupferschicht
in den Durchgangslöchern (4) verstärkt wird.

0062300

1/1

